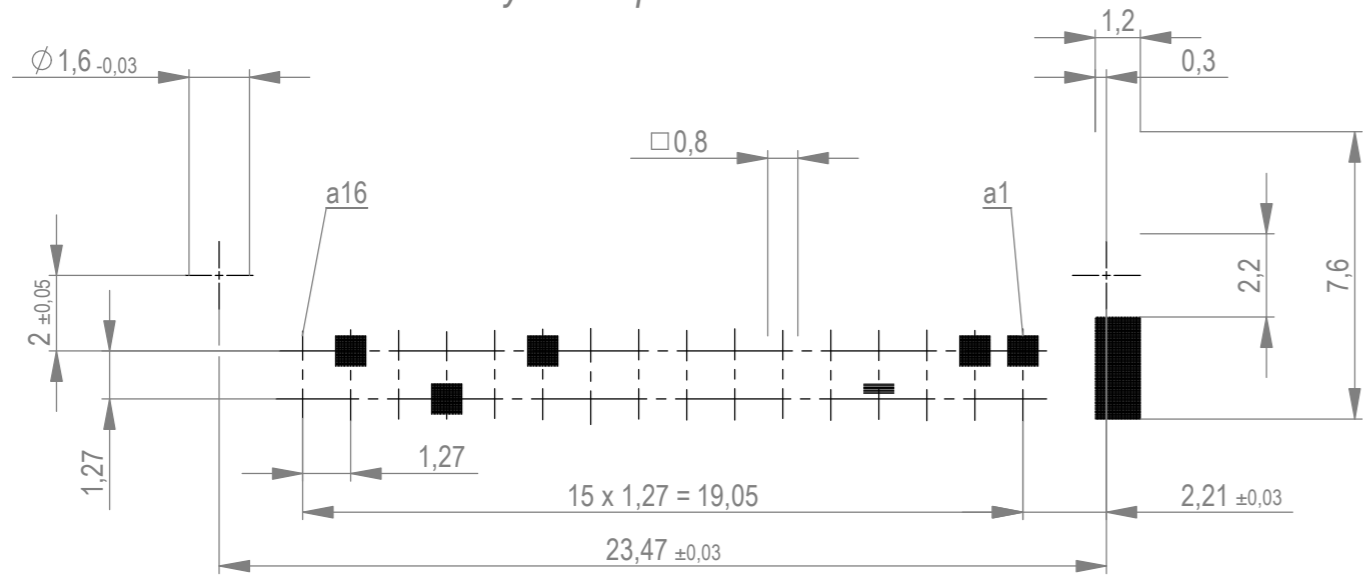
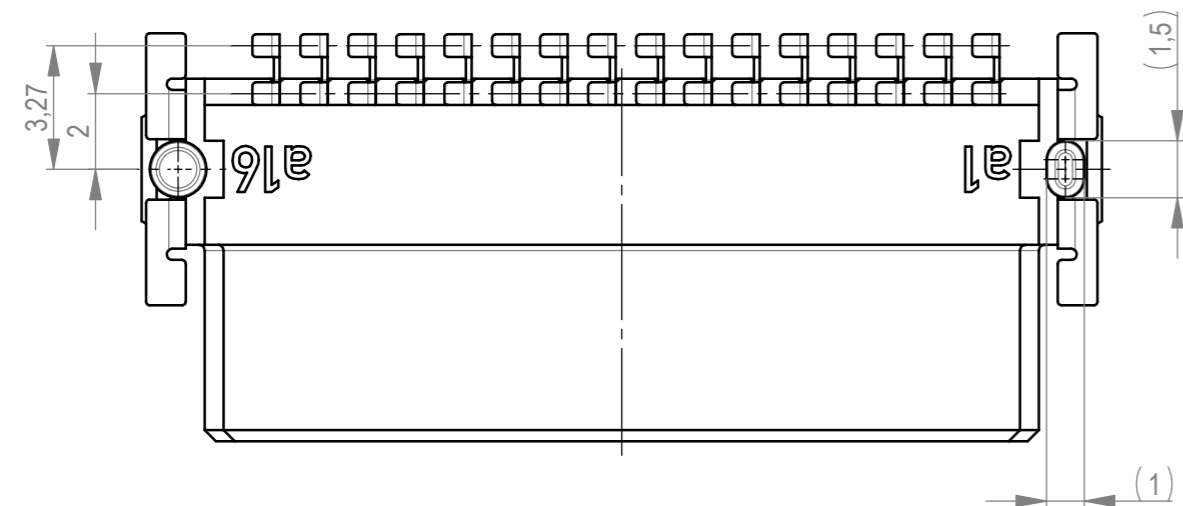
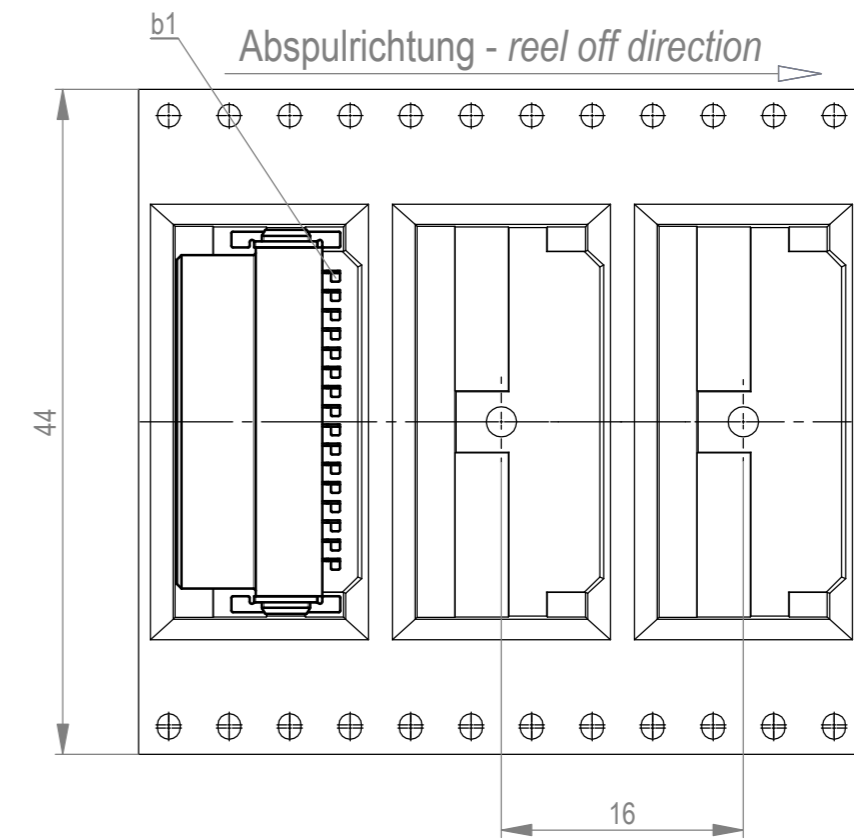
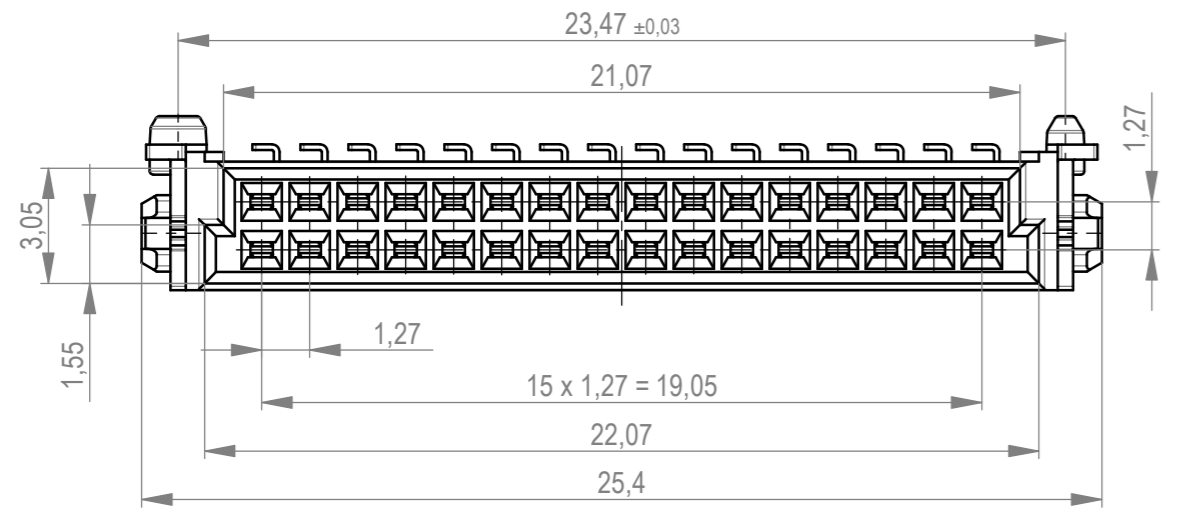
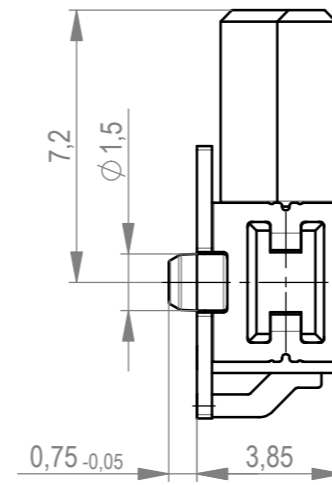
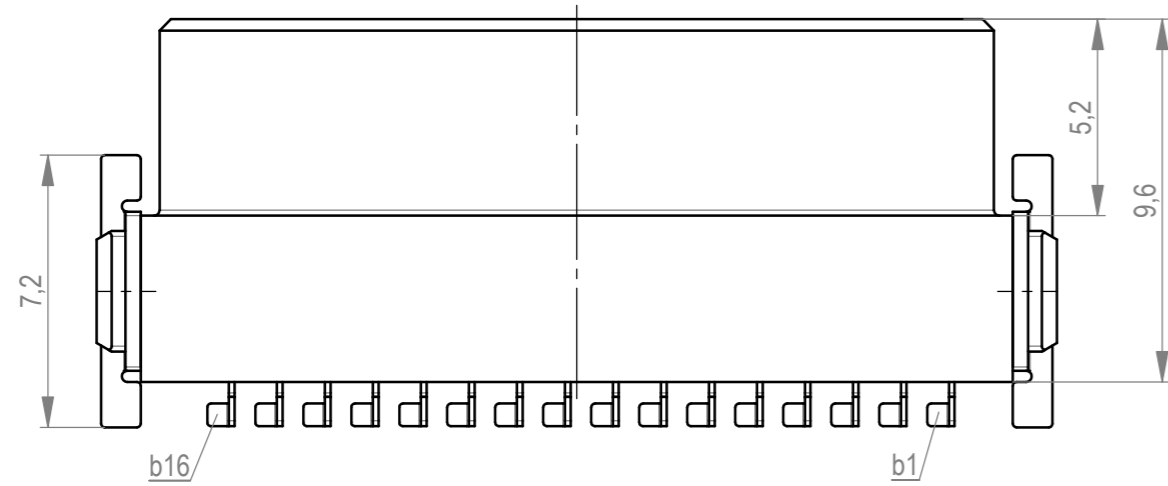
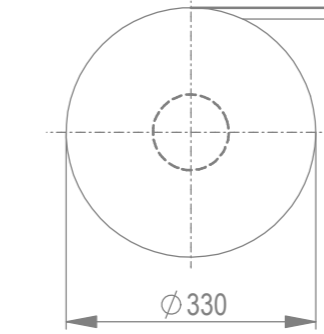


Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT



Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 560 Stück
packaging unit: 560 pcs



Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

BA7-03 - Standard Bauhöhe
type7-03 - standard assembly height

Dimension no.	Tolerances ISO 8015	Scale 5:1	Material
Customer drawing: This Drawing is a controlled Document.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	Federl. SMC-Q 32-SMD-BA7-03 Female SMC-Q 32-SMD-type7-03	
TE Connectivity		C-354080-E	
c1 Index	12.05.2023 Date	Class SMCQ	C A2

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Einweisung der Handlung. Bei Abweichungen vom englischen Original gilt das englische Original. This drawing has been created for convenience only and may deviate from the original. In case of any deviation the English version shall prevail.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Urheberrechts- oder sonstigen Schutzrechte vorbehalten.